

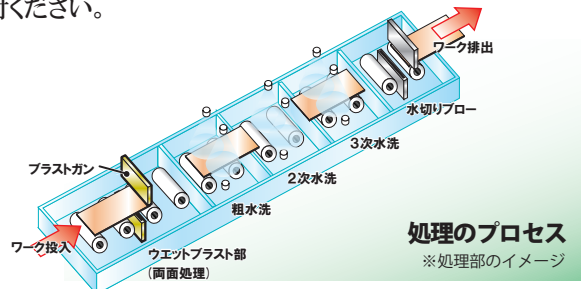
小物ワーク対応の小型・低価格装置を開発。



この度マコーは、プリント配線板や半導体などの電子部品業界向けに、より小さなワークに対応できる小型で低価格な装置を開発いたしました。

この装置は、従来特注対応だった小物ワークに標準で対応でき、最小口20×50mmまでのワークを搬送し処理できます。また、処理室内の小型化や構造の簡略化により、ウェットブラストの処理品質はそのままに、従来機に比べ小型で、2/3の価格を実現いたしました。

小さく、スペース生産性の高い新型機「Mini PFE 100,200」をご検討ください。



Mini PFEの特徴

小型・ローコスト

ウェットブラストの処理品質はそのままに、機能を凝縮。小型ローコスト装置として新開発いたしました。

小型薄物ワーク対応

従来機「PFE」では特殊仕様だったワークサイズ□20×50mmの搬送機構を標準化し、より小物ワークの処理に特化した専用装置。

簡単メンテナンス

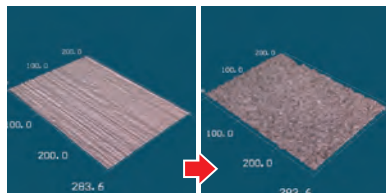
ブラスト、水洗部をコンパクト化し、コンベアカバーを開けるだけで駆動部のメンテナンスが可能。また、主要部品である幅広ノズルとポンプは従来通りの高耐久性。

ご利用頂ける主な処理目的

濡れ性・密着性改善

前処理としての表面粗化

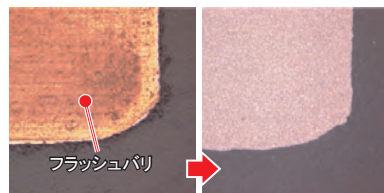
対象表面に無方向性のテクスチャリングを行うことで、濡れ性・密着性改善効果を得ることができます。



微細バリ取り

ヒートシンクのフラッシュバリ取り

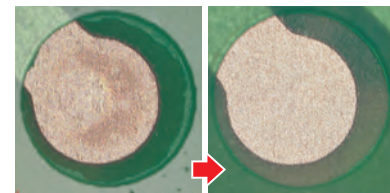
微細研磨材を用いることにより、パッケージ本体にダメージを与えずにフラッシュバリのみを除去できます。



洗浄・異物除去

パッケージ基板の金めっき前洗浄

表面についた油や微小な異物など、汚れの材質を問わずに除去・洗浄することができます。




 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。連絡先：マコー株式会社 本社 営業部 橘 和寿宛
<http://www.macoho.co.jp> inquiry@macoho.co.jp